

NEW

HAMAMATSU PHOTONICS Failure analysis systems

Sequencer software

Dual PHEMOS®-X & iPHEMOS®-MPX対応 自動解析ソフトウェア

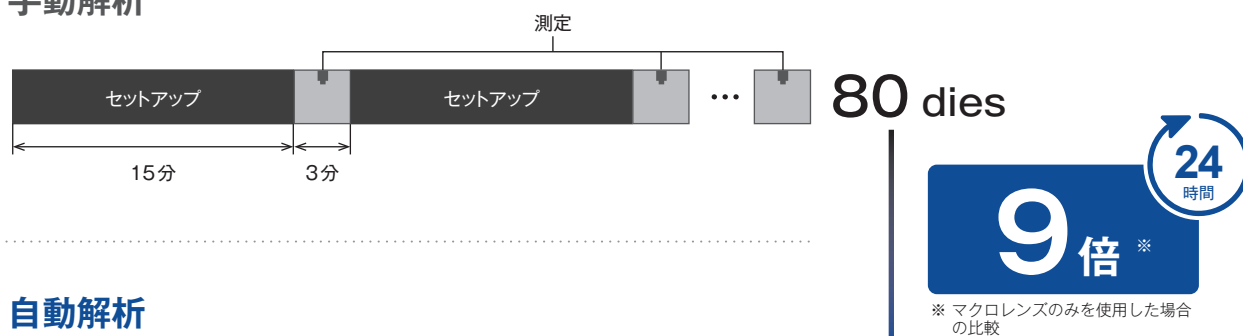
ウェーハレベルでの自動故障解析を実現

手動EFAでは、ウェーハ全体のダイ比較に時間がかかってしまい、解析できるダイの数が制限されます。Sequencerソフトウェアにより自動でダイ間解析を実現し、ウェーハ全体の不良傾向を可視化します。

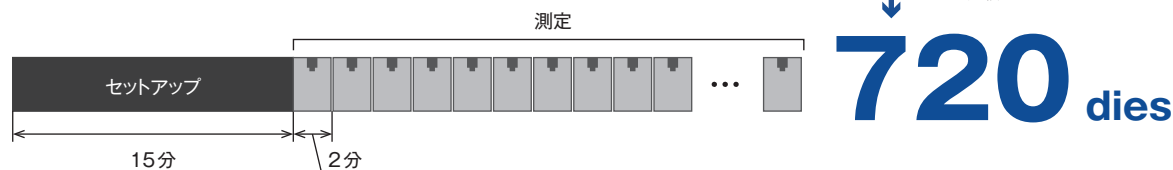
ダイ間の解析スループットを向上

手動解析ではデータ収集に時間がかかることが多く、少数のダイであっても画像取得に数時間を要する場合があります。当社の半導体故障解析装置にSequencerソフトウェアを搭載することで自動でのダイ間解析を実現します。マクロレンズ使用時には24時間以内に最大720diesの測定が可能で、従来比9倍のスループットを達成します。

手動解析

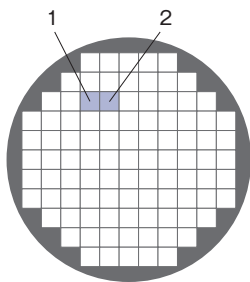


自動解析

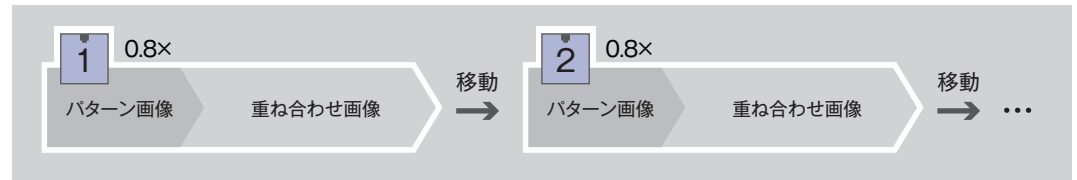


ウェーハレベルで故障を特定、ダイの解析まで自動化

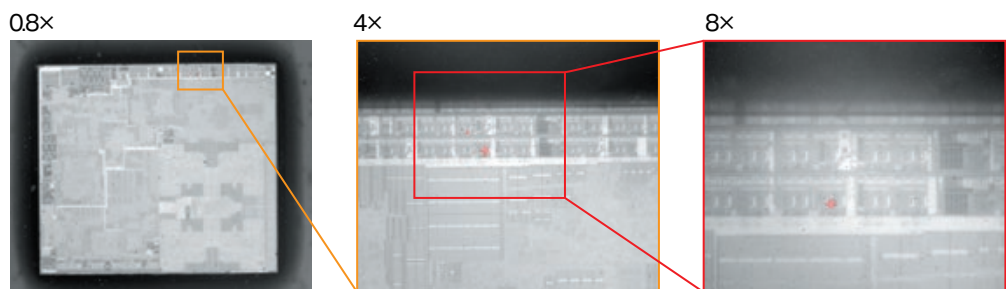
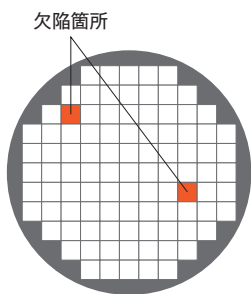
1. マクロレンズで自動ダイ間解析を実行



自動でダイ間解析を実行



2. 欠陥箇所を自動抽出し、拡大して詳細な解析を実行



SequencerソフトウェアはDual PHEMOS-X、iPHEMOS-MPXに対応しています。



製品詳細はWEBページをご参照ください。

<https://www.hamamatsu.com/jp/ja/product/semiconductor-manufacturing-support-systems/failure-analysis-system.html>



レーザ製品の安全対策について

Dual PHEMOS-X、iPHEMOS-MPXは、クラス1レーザ製品です。当社はJIS(C6802)に従い、製造業者が行うべき安全予防対策として、レーザのクラス分けを行い、そのクラスに対応する安全対策およびラベル表示を実施しています。ご使用の際には使用者としての安全予防対策もJISに従い実施してください。

クラス 1 レーザ製品

▲表示ラベル (サンプル)



▲警告ラベル

- iPHEMOS、PHEMOSは、浜松ホトニクス(株)の登録商標です。
- その他の記載商品名、ソフトウェア名などは該当商品製造会社の商標または登録商標です。
- カタログに記載の測定例は代表例を示すもので、保証するものではありません。
- カタログの記載内容は2026年6月現在のものです。本内容は改良のため予告なく変更する場合があります。